



Stannol Lötpaste SP6000 TSC305 Sn96,5Ag3Cu0,5 Dose 500g

Artikel-Nr: 696001
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 117.80

Beschreibung

Die Lotpaste SP6000 gehört zur nachhaltigeren greenconnect-Produktlinie von Stannol. Das Besondere: Mit dieser Lotpaste lassen sich unter anderem durch den Einsatz von Recycling-Lot im Vergleich zu herkömmlichen Lotpasten mehr als 85 Prozent der CO₂-Emissionen einsparen. Die Lotpaste wurde sowohl für den Einsatz mit der Legierung TSC305 (Sn96,5Ag3Cu0,5) als auch für den kostensparenden Einsatz mit niedrigem Silbergehalt mit der Legierung TSC105 (Sn98,5Ag1Cu0,5) entwickelt. Das als REL0-klassifizierte Flussmittel überzeugt zudem unter Luft- wie auch Stickstoffatmosphäre mit einer kompromisslosen Benetzungsqualität auf allen bekannten bleifreien Leiterplatten- und Bauteilbeschichtungen. Die SP6000 hinterlässt aussergewöhnlich wenig Rückstände, die zudem transparent und nicht korrosiv sind.

Anwendungsgebiete

Die Lotpaste SP6000 wurde für den Schablonendruck entwickelt. Mit der TSC105- bzw. TSC305-Legierung als Lotpulver in Korngrösse 3 (25 bis 45 µm) und 4 (20 bis 38 µm) ist die Lotpaste SP6000 in allen gängigen offenen und geschlossenen Drucksystemen einsetzbar.

Technische Daten

- Lotpulver aus Recycling-Lot
- mehr als 85 Prozent CO₂-Ersparnis
- sehr gut für den Einsatz mit niedrigem Silbergehalt (TSC105) geeignet
- hohe Konturenstabilität, geeignet für Fine-Pitch bis 0,4 mm
- sehr gutes Andrucken nach längerem Stillstand des Druckers
- Reflow-Lötprozess unter Luft oder Stickstoff möglich
- geringes Mid-Chip Balling an passiven Bauteilen, aufgrund von Anti-Kapillar-Effekt
- sehr gute Benetzung auf den meisten Oberflächen
- RoHS-konform

Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Bleihaltig	Nein
Flussmittel	REL0
Gebinde	Dose

Gebindegrösse (g)	500
Korngrösse	4
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Schmelztemperatur (°C)	217-223